

H6-系统硬件设计概要

何名兴 20170730



- ◆ H6无线通讯方案支持接口
- ◆ H6调试验证支持模组
- ◆ 典型模组设计举例
- ◆验证测试项



- ◆ H6无线通讯方案支持接口
- ◆ H6调试验证支持模组
- ◆與型複组设计举级以为
- ◆验证测试顶



- ✓ WiFi通讯支持接口
 - ◆SDIO 2.0, 3.0
 - ◆USB 2.0, 3.0
 - ◆PCIE 1.0 , 2.0
- ✓ BT通讯支持接口
 - **♦USB**
 - **◆UART**
 - **◆**PCM



- ◆ H6无线通讯方案支持接口
- ◆ H6调试验证支持模组
- ◆與型模组设计举及火沙
- ◆ 验证测试项





- ✓ 调试验证支持模组
 - ◆验证调试了四大厂商的主流的WiFi-BT通讯模组。

					7		
厂商	模组型号	WIFI接口	WiFi速率模式	bt接口	BT速率模式	天线数	频段
xradio	XR819	SDIO	B/G/N	无	7	1	2. 4G
	RTL8188etv/eu	USB	B/G/N	无	750	1	2. 4G
	RTL8189etv	SDIO	B/G/N	无	$\lambda \lambda$	1	2. 4G
	RTL8192eu	USB	B/G/N	无	()-	2	2. 4G
	RTL8723bs	SDIO	B/G/N	UART	4. 0	1	2. 4G
realtek	RTL8723bu	USB	B/G/N 🝑	USB	3. 0	1	2. 4G
	AP6181	SDIO	B/G/N	无	-	1	2. 4G
	AP6210	SDIO	B/G/N	UART	4. 0	1	2. 4G
	AP6212	SDIO	B/G/N	UART	4. 0	1	2. 4G
	AP6330	SDIO	A/B/G/N	UART	4. 0	1	2. 4G/5G
	AP6335	SDIO	A/B/G/N/AC	UART	4. 0	1	2. 4G/5G
	AP6255	SDIO	A/B/G/N/AC	UART	4. 1	1	2. 4G/5G
broadcom	AP6356S	SDIO	A/B/G/N/AC	UART	4. 1	2	2. 4G/5G
Atheros	WCT6RA2001S	SDIO	A/B/G/N/AC	UART	4. 2	2	2. 4G/5G



- ◆H6无线通讯方案支持接口。(译))
- ◆H6调试验证支持模组
- ◆ 典型模组设计举例
- ◆验证测试项



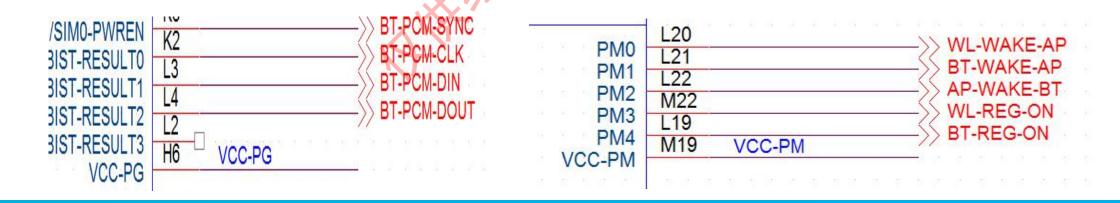
- ✓ 典型模组设计举例
 - ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。

- ◆WIFI-BT模组 电源兼容了内部AXP和外部DCDC供电。
- ◆<u>可以根据是否需要蓝牙谣控开机功能讲行选</u>择。

BT遥控开机功能	WiFi-BT电源选择
需要	外部DCDC
不需要	内部AXP



- ✓ 典型模组设计举例
- ✓ SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
 - ◆H6系统对WIFI-BT模组 电源做了1.8V 和 3.3V IO电压兼容设计。
 - ◆1,可以根据SDIO速率和模组IO电压进行选择。
 - ◆2,PG和PM单独划分电源域,与WIFI-IO电压保持一致。





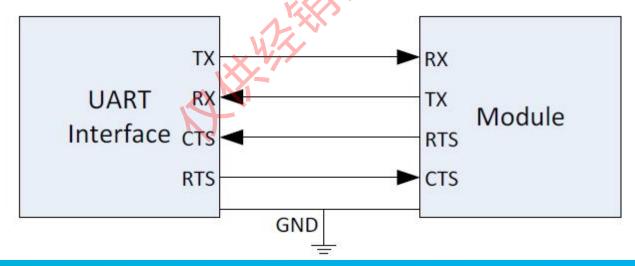
✓ 典型模组设计举例

- ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
- ✓ 1, SDIO clk信号线,需要加RC电路并且靠近主控摆放,降低对外辐射。

SDIO CIV 亜进行包押贷款 **『冬/エッナカト**4戸自士 RC3 33R R0402 WL-SDIO-CLK PG0/SDC1-CLK WL-SDIO-CMD PG1/SDC1-CMD J5 WL-SDIO-D0 PG2/SDC1-D0 H₂ WL-SDIO-D1 PG3/SDC1-D1 L5 WL-SDIO-D2 PG4/SDC1-D2 H5 WL-SDIO-D3 PG5/SDC1-D3 H4 BT-UART-RX PG6/UART1-TX J6 BT-UART-TX PG7/UART1-RX BT-UART-CTS STA-DB/SIM0-VPPEN **BT-UART-RTS** T-GPIO/SIM0-VPPPP

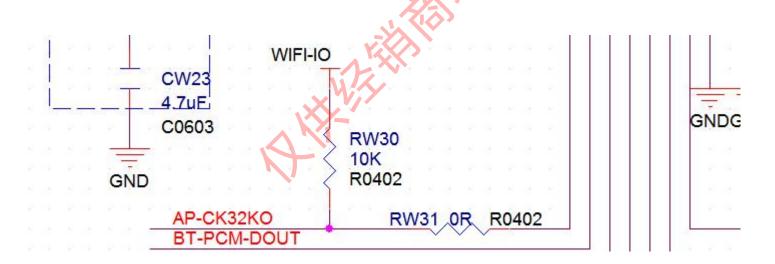


- ✓ 典型模组设计举例
 - ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
 - ✓ 1,BT-UART通讯口,与主控TX,RX对接交互,需要两两交叉对接。
 - ✓ 2,BT-PCM通讯口,与主控TX,RX对接交互,需要两两交叉对接。





- ✓ 典型模组设计举例
 - ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
 - ✓ 1,32K时钟AP-CK32KO需要WiFi-IO电压做上拉。

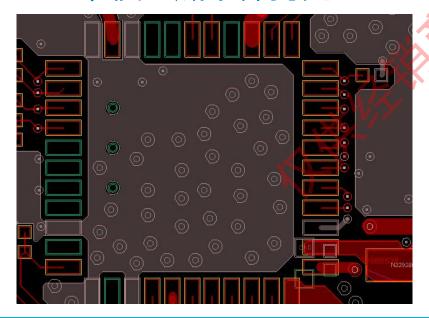


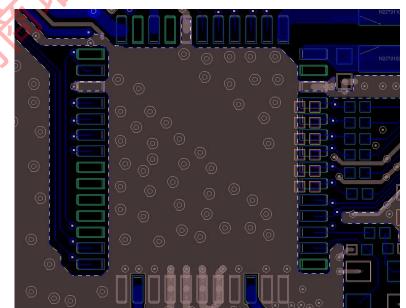


✓ 典型模组设计举例

◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。

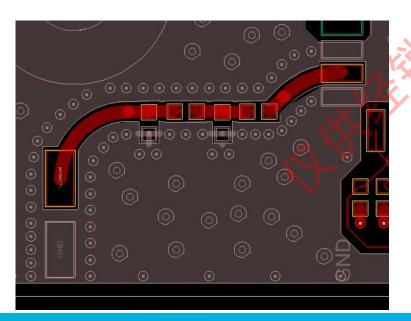
✓ 1,模组底下保持完整地

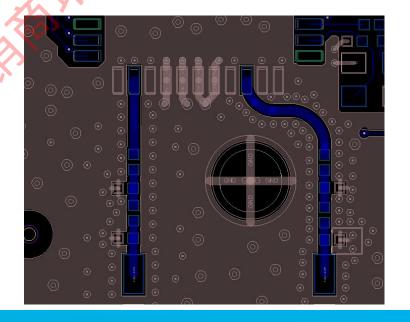






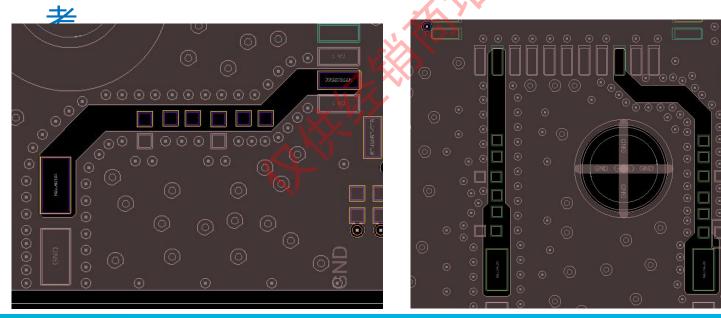
- ✓ 典型模组设计举例
 - ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
 - ✓ 1,射频保持50欧姆阻抗线,并模组RF pin保持完整包地。







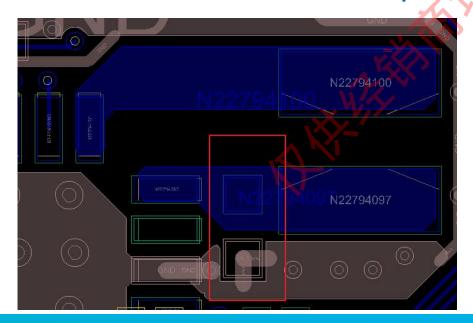
- ✓ 典型模组设计举例
 - ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
 - ✓ 1,射频保持50欧姆阻抗线,建议挖空相邻层,做隔层参







- ✓ 典型模组设计举例
 - ◆SDIO 44pin 12*12 封装模组,50pin 13*15 封装模组。
 - ✓ 1,模组内部供电 电容靠pin 脚摆放。





- ◆H6无线道讯方案支持接口。()())
- ◆ H6调试验证支持模组
- ◆验证测试项



- ✓ 验证测试项
 - ◆TX 功率 @ MCS7 > 12dBm
 - ◆EVM @ MCS7 < -28dB
 - ◆RX 灵敏度 @MCS7 < -68dBm
 - ◆ANT 耦合测试 @MCS7 EVM < -28 dB
 - ◆2T2R 隔离度 @2.4G > 20dB



- ✓ 验证测试项
 - ◆屏蔽房Thoughput @ 1*1N20 > 40Mbps ; @ 1*1N40 > 70Mbps
 - ◆室外空旷环境30米Thoughput @ 1*1N20 > 20Mbps
 - ◆室外隔墙10米Thoughput @ 1*1N20 > 20Mbps



- ✓ TX 功率 @ MCS7 > 12dBm
 - ◆目的:验证WiFi A/B/G/N/AC速率模式的发射功率。
 - ◆方法:使用cable线,连接综测仪或功率计测试。
 - ◆典型应用测试项B/N/AC的高中低信道的功率。



- ✓ EVM @ MCS7 < -28dB</p>
 - ◆目的:验证WiFi 信号传输过程EVM指标。
 - ◆方法:使用cable线,连接综测仪或频谱仪。
 - ◆典型应用测试项B/N/AC的高中低信道的EVM。



✓ RX 灵敏度 @MCS7 < -68dBm

◆目的:验证WiFi 系统接受灵敏度。

◆方法:使用cable线,连接综测仪或信号发生仪。

◆典型应用测试项B/N/AC的高中低信道的灵敏度。



- ✓ ANT 耦合测试 @MCS7 EVM -28 dB
 - ◆目的:验证WiFi 信号通过天线送到空间的信号质量。
 - ◆方法:
 - ◆ 1,盒子系统通过天线对外辐射WiFi信号。
 - ◆ 2,接综测仪或频谱仪通过天线分析空间中的WiFi信号。
 - ◆典型应用测试项N模式的高中低信道信道的EVM水平。



✓ 2T2R 隔离度 @2.4G > 20dB

◆目的:避免双天线之间相互干扰。

◆方法:使用网络分析仪测试双天线的S12或S21

◆典型应用测试项2.4G频率〉隔离度 > 20dB



- ✓ 屏蔽房Thoughput
 - ◆目的:验证没有外界干扰的状态下,WiFi系统的最佳性能。
 - ◆方法:在屏蔽房内,测试WIPi的吞吐量。
 - ◆典型应用测试项2.4G N模式



✓ 室外空旷环境30米Thoughput

◆目的:验证WiFi系统远距离传输能力。

◆方法:在空旷无阻挡环境下,测试WiFi吞吐量

◆典型应用测试项2.4G 高中低信道吞吐量



- ✓ 室外隔墙10米Thoughput
 - ◆目的:模拟家庭复杂环境,WiFi的实际吞吐量
 - ◆方法:在空旷盒子与路由距离10米,中间相隔实体墙。
 - ◆典型应用测试项2.4G 高中低信道吞吐量



